

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷作業時のインク供給ムラや不足などにより出来たもの（SR印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR印刷作业时油墨的供给不均匀，或者不充分所造成的（SR印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
Caused by uneven or insufficient feed of the ink in solder resist printing (solder resist printing process)



【コメント】  
顕微鏡倍率×5  
【注釋】  
显微镜倍率×5  
【Comments】  
Magnification: ×5

## 2-1-1-16 SR 割れ／SR 的裂缝／Solder resist crack

【特徴】SR表面がひび割れしている状態の欠陥

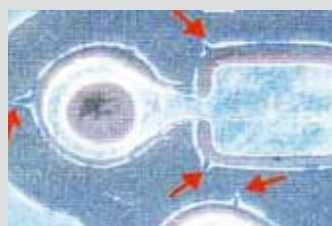
【特征】SR表面出现微裂缝的缺陷。

【Characteristics】Solder resist surface is cracked.

【原因・判断ポイント・発生工程】不良SRや調合不良のSRインクが乾燥によりひび割れして出来たもの（SR印刷、塗布～乾燥工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR不良或者油墨调制不良等，烘干后出现的微裂缝（SR印刷、涂布～乾燥工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
A defective solder resist ink or an improper solder resist formulation causes the cracks after curing. (Solder resist printing - curing process)



【コメント】  
顕微鏡倍率×20  
【注釋】  
显微镜倍率×20  
【Comments】  
Magnification: ×20



【コメント】  
顕微鏡倍率×  
【注釋】  
显微镜倍率×  
【Comments】  
Magnification: ×

## 2-1-2 不注意（SR 欠陥）／疏忽（SR 的缺陷）／ Caused by careless mistake(Solder resist defects)

### 2-1-2-1 SR インク切れかすれ／SR 油墨中断的漏印／Solder resist blur by ink run-out

【特徴】SRが末広がり状に塗布されていない状態の欠陥

【特征】被涂布的SR没有逐渐扩展的缺陷。

【Characteristics】Coated solder resist does not spread out in printing.



【コメント】  
顕微鏡倍率×  
【注釋】  
显微镜倍率×  
【Comments】  
Magnification: ×